LİNEER ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (LLDPE)

LF920AA

Hexene LLDPE

Mükemmel fiziksel özellikler ve üstün ısıl yapışma (heat sealing) kapasitesi. Kalınlık optimizasyonu (down-gauging) ve harmanlama (blending) için ideal, yüksek performanslı polimer çözümü.

NotebookLM

Temel Performans Göstergeleri

Kritik proses ve mekanik değerlere hızlı bakış.



Melt Index

1.0

g/10 min | D 1238



Yoğunluk

0.919

g/cm³ | D 1505



Dart Darbe

220

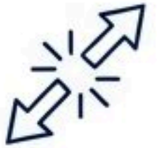
g/mil | D 1709



Pusluluk / Haze

%15.0

D 1003



Çekme Kopma

MD 5,900 psi / TD 4,100 psi

D 882

Testler aksi belirtilmedikçe 23°C (73°F) sıcaklık ve %50 bağıl nemde ASTM standartlarına (1.0 mil film, 2.5:1 BUR) göre yapılmıştır.

NotebookLM

İdeal Uygulama Alanları

Endüstriyel ve tarımsal ambalaj çözümlerinde üstün dayanım ve formlanabilirlik.



Ağır Hizmet Torbaları ve Çuvalları

Tarım Filmleri

Çöp Torbaları ve Astarları

Ko-ekstrüde Yapılar

Streç Filmler

NotebookLM

Neden LF9220AA Tercih Edilmeli?

Dayanım ve maliyet ekonomisi arasında optimum denge.

Kalınlık Optimizasyonu (Down-gauging)

Üstün fiziksel özellikleri sayesinde, ambalaj performansından ödün vermeden film kalınlığını azaltarak maliyet avantajı sağlar.

Güvenilir Isıl Yapışma (Heat Sealing)

Ambalaj hattında hızlı ve hatasız üretim için mükemmel ısıl yapışma karakteristiği sunar.

Esnek Harmanlama (Blending)

Prosesinizde genel özellikleri iyileştirmek amacıyla diğer polimer malzemelerle sorunsuz harmanlanma imkanı tanır.

NotebookLM

Hangi Durumlarda Alternatif Aranmalı?

Doğru polimeri doğru proseste kullanmak performansın anahtarıdır.

Hızlı Enjeksiyon Prosesleri

Malzeme öncelikli olarak şişirme (blown) film prosesi için tasarlanmıştır. 1.0 MFI (Melt Index) değeri, standart enjeksiyon kalıplama için çok düşüktür.

Cam Berraklığı Beklentisi

%15.0 pusluluk (haze) oranına sahiptir. Ultra yüksek optik şeffaflık aranan lüks tüketici ambalajları için uygun değildir.

Teyitsiz Gıda Teması

21 CFR (FDA) kapsamında bazı onaylara sahip olsa da, her nihai ürün/uygulama için doğrudan regülasyon departmanından özel teyit alınması şarttır.

NotebookLM

Üretim Prosesi ve Katkı Notları

Optimum ekstrüzyon performansı ve özel formülasyon seçenekleri.



Sıcaklık Profili

Şişirme (blown melt) proseslerinde önerilen ideal eriyik sıcaklığı **400°F – 420°F** aralığındadır.



Modüler Katkılar

Üretim ihtiyaçlarınıza göre çeşitli seviyelerde kaydırıcı (slip) ve bloklanma önleyici (antiblock) katkılı versiyonları mevcuttur.



Regülasyon

Malzeme standart olarak Kosher uyumludur. Özel regülasyon belgeleri sipariş öncesi talep edilebilir.

NotebookLM

Karar Özeti

LF9220AA; 220 g/mil üstün darbe dayanımını ve %670-900 bandındaki yüksek uzama kapasitesini, güvenilir ısıl yapışma ile birleştiren endüstriyel standartta bir Hexene LLDPE'dir.

Ambalaj kalitesinden taviz vermeden film kalınlığını düşürmek isteyen üreticiler için ideal mühendislik çözümüdür.